

证券代码：603061

证券简称：金海通

天津金海通半导体设备股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-013

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场访谈 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 线上分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 线上调研
参与单位名称	易方达基金、富国基金、招商证券、中邮证券、华富基金、鹏扬基金、财通资管、国金证券、银河基金、长城基金、国泰人寿、财通基金、宝盈基金、东方证券资管、国联安基金、APS（以上排名不分先后） 业绩说明会：参与业绩说明会的投资者	
时间	2024年11月5日至2024年11月6日	
地点	线上调研：腾讯会议 路演：上海市浦东新区东方路778号、上海市浦东新区陆家嘴环路1318号、上海市浦东新区世纪大道1196号、上海市浦东新区张杨路769号、上海市浦东新区富城路99号 特定对象调研：上海市青浦区嘉松中路2188号 业绩说明会：上证路演中心（ http://roadshow.sseinfo.com ）	
上市公司接待人员姓名	副总经理兼董事会秘书刘海龙先生	
投资者关系活动主要内容	一、公司介绍主要内容 金海通的主营业务为集成电路测试分选机的研发、生产及销售，	

要内容介绍	<p>客户群体涵盖半导体封装测试企业、测试代工厂、IDM 企业（半导体设计制造一体化厂商）、芯片设计公司等。公司产品在集成电路封测行业有较高的知名度和认可度，产品遍布中国大陆、中国台湾、欧美、东南亚等全球市场。</p> <p>公司自成立以来，始终坚持深耕集成电路测试分选机的研发、生产和销售。公司深耕平移式测试分选机领域，产品根据可测试工位、测试环境等测试分选需求分为 EXCEED-6000 系列、EXCEED-8000 系列、EXCEED-9000 系列、SUMMIT 系列、COLLIE 系列、NEOCEED 系列等。</p> <p>公司的核心技术集中于“高速运动姿态自适应控制技术”、“高兼容性上下料技术”、“高精度温控技术”、“芯片全周期流程监控技术”等领域。公司产品的软件定制化程度高，集成程度高，反馈速度快，技术支持响应度好；产品的 UPH（单位小时产出）、Jam rate（故障停机率）、可并行测试最大工位等指标已达到同类产品的国际先进水平。</p> <p>二、公司 2024 年前三季度业绩情况介绍</p> <p>2024 年前三季度，公司实现营业收入 2.56 亿元，较上年同期下降 4.59%，公司实现净利润 4,492.84 万元，较上年同期下降 14.78%。</p> <p>2024 年第三季度，公司实现营业收入 7,319.42 万元，较上年同期下降 11.24%；2024 年第三季度，公司实现净利润 525.16 万元，较上年同期下降 32.33%，主要系营业收入下降、股份支付等费用增加所致。</p> <p>2024 年前三季度，公司经营活动产生的现金流量净流入 2,243 万元，较上年同期经营活动产生的现金流量净流出 8,365.99 万元有一定程度的改善。</p> <p>截至 2024 年 9 月末，公司总资产为 14.98 亿元，较上年末下降 5.46%；净资产为 12.78 亿元，较上年末下降 8.64%。</p> <p>三、调研问答</p> <p>1、问：目前产品研发方面是如何规划的？</p> <p>答：公司深耕平移式测试分选机领域，产品根据可测试工位、测试环境等测试分选需求分为 EXCEED-6000 系列、EXCEED-8000 系列、</p>
-------	--

EXCEED-9000 系列、SUMMIT 系列、COLLIE 系列、NEOCEED 系列等。

研发方面，公司将延续今年年初的计划，进一步跟进三温测试分选设备的定制化需求，持续加强针对新能源、电动汽车及 AI 运算等相关领域芯片测试分选的技术研发，继续加大对适用于 Memory、MEMS 及专用于先进封装产品的测试分选平台的研发力度。同时，公司也将积极布局重点关注的技术方向。

2、问：适用于 MEMS 的测试分选平台目前进展如何？

答：MEMS 相关产品类型很多，客户倾向定制化产品，单台机器价值较高。公司正与客户（设计公司）合作定制化开发，并进行技术积累。

3、问：适用于 Memory 的测试分选平台的进展如何？

答：公司正进行前瞻性研究及技术积累，基于部分客户的定制需求正在推进定制化项目开发。

4、问：人员方面较以前年度是否有变化？

答：公司员工总数无较大变化。目前公司管理体系仍相对灵活，未来将结合生产经营、研发进展、客户端需求等实际情况进行人员规划。

5、问：目前看，订单能见度以及交货周期如何？

答：和之前差不多，一般情况下，客户会与公司进行持续性的常态化沟通，对公司产品的技术指标及交货周期等进行了解。对于量产机型及标准选配功能，公司具有快速交货能力。基于这种情况，客户通常会在需求相对确定时下单。

四、业绩说明会问答

1、问：现在管理层鼓励上市公司并购收购资产，公司在半导体行业有没有可能收购一些相关资产做大做强？

答：公司主营业务为集成电路测试分选机的研发、生产及销售，集成电路测试分选机主要应用于集成电路设计阶段中的验证环节和封

装测试阶段的成品测试环节，客户群体涵盖半导体封装测试企业、测试代工厂、IDM 企业（半导体设计制造一体化厂商）、芯片设计公司等。

公司自成立以来深耕集成电路测试分选机领域，经过多年的研发和创新，公司产品的技术指标及功能达到同类产品国际先进水平。

公司将结合中长期战略发展规划，持续评估收购或并购等事项，若后续有相关事项，公司将严格按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

2、问：公司有哪些技术优势，目前的市场表现如何？

答：公司主营业务为集成电路测试分选机的研发、生产及销售。公司的核心技术集中于“高速运动姿态自适应控制技术”、“高兼容性上下料技术”、“高精度温控技术”、“芯片全周期流程监控技术”等领域。公司产品的软件定制化程度高，集成程度高，反馈速度快，技术支持响应度好；产品的 UPH（单位小时产出）、Jam rate（故障停机率）、可并行测试最大工位等指标已达到同类产品的国际先进水平。

公司深耕平移式测试分选机领域，产品根据可测试工位、测试环境等测试分选需求分为 EXCEED 系列、SUMMIT 系列、COLLIE 系列、NEOCEED 系列等。客户群体涵盖半导体封装测试企业、测试代工厂、IDM 企业（半导体设计制造一体化厂商）、芯片设计公司等。公司的产品在集成电路封测行业有较高的知名度和认可度，产品遍布中国大陆、中国台湾、欧美、东南亚等全球市场。

3、问：公司目前订单状况如何？

答：公司主营业务为集成电路测试分选机的研发、生产及销售，客户群体涵盖半导体封装测试企业、测试代工厂、IDM 企业（半导体设计制造一体化厂商）、芯片设计公司等。

公司的业务在稳步推进，公司将继续保持以技术为核心的策略，加大市场拓展力度，依靠自身技术优势，针对客户的定制化需求，提供更优质的服务。公司严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务，

	具体信息请以公司在指定信息披露平台披露的公告为准。
附件清单 (如有)	无
风险提示	以上如涉及公司所处行业发展趋势、公司发展规划等相关内容，不代表公司或公司管理层对行业发展、公司发展或业绩的预测和承诺，不构成公司或公司管理层对投资者的实质性承诺，敬请广大投资者注意投资风险。
日期	2024年11月7日